

拒絶理由通知書

特許出願の番号	平成11年 特許願 第016258号
起案日	平成13年 2月 6日
特許庁審査官	齋藤 恭一 1684 4L00
特許出願人代理人	工藤 実 (外 1名) 様
適用条文	第29条第2項、第29条の2

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公告（特許掲載公報の発行）又は出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同じではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

続葉有

続 葉

- ・理由 1
- ・請求項 1～10
- ・引用文献等 1～3
- ・備考

引用例1には、2段階のエッチングによりビアホールを形成すると共に、ビアホールに酸素プラズマ処理を行い、更に銅表面の酸化銅を還元することが記載されている。

クリーニング処理として、低酸素分圧でのアニールや水素雰囲気中での還元処理は、引用例2、3に記載されるように周知技術であり、これを引用例1記載の方法に適用することは、当業者が容易になし得ることである。

なお、バリア膜を形成することは慣用手段であって、当業者が必要に応じてなし得ることである。

- ・理由 2
- ・請求項 1～10
- ・引用文献等 4
- ・備考

先願4に記載された発明の実施の形態を参照。

引 用 文 献 等 一 覧

1. 特開平10-261715号公報
2. 特開昭63-313836号公報
3. 特開平06-224194号公報
4. 特願平10-019244号 (特開平11-220021号)

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 IPC第7版 H01L21/3205～ 21/3213
H01L21/768

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。